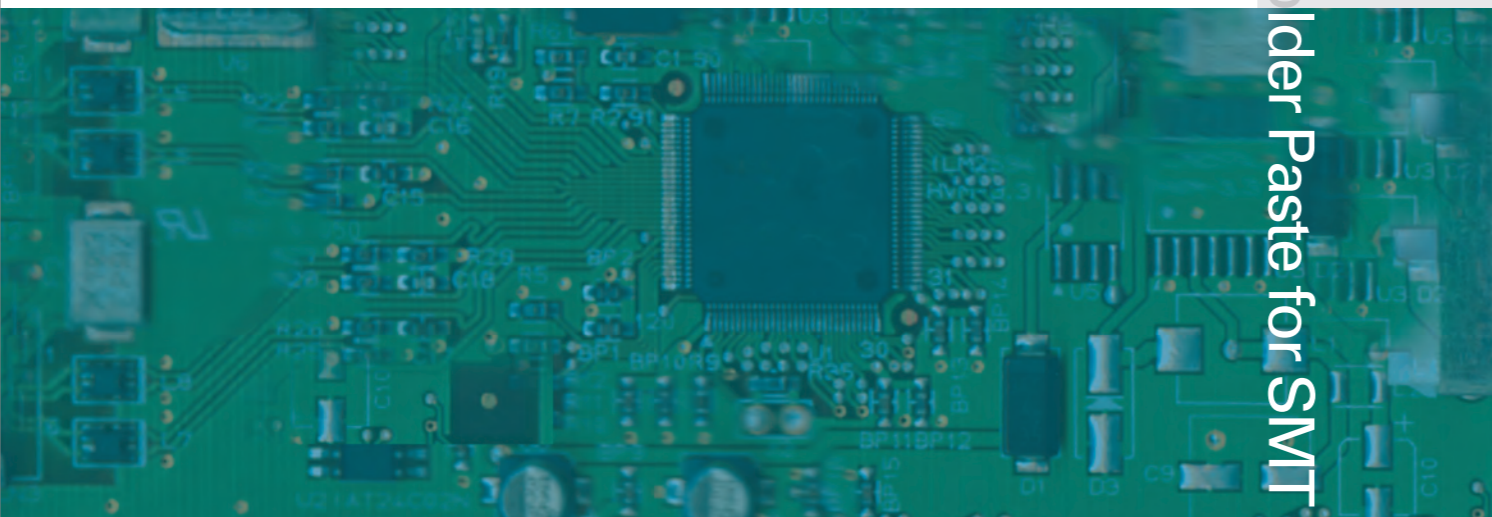


PF305-V302HO

SMT用鉛フリーソルダペースト

ボイド低減高性能タイプ Vシリーズ

- リフロー条件を問わず、優れたボイド抑制効果
The excellent reduced void under any reflow conditions.
- ニッケル等の濡れ難い材質への濡れ性を向上
The excellent wettability to difficult wetting such as nickel.
- パワー半導体などの大面積接合部に対応
Corresponding for large-area soldering such as power devices.



High Performance Type Solder Paste for SMT

PF305-V302HO

● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-3.0Ag-0.5Cu	-
粒度 Particles Size	25~45 μm	-
フラックス含有量 Flux content	12.5%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content (chlorine conversion)	0.30%	配合値 Blend Value
はんだボール試験 Solder ball test	Good	Our test method
予備加熱時のダレ試験 Slump test in preheating	Pass 0.5mm	JIS Z 3284
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH	2.3 × 10 ¹² Ω
	85°C85%RH	3.8 × 10 ⁹ Ω
100g以上粘着保持時間 Tackiness time of keeping 100g (50kN/m ²) minimum	24 hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity	197 Pa·s
	Ti値 Thixotropic index	0.43

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

PF305-V302HO

SMT用鉛フリーソルダペースト

ボイド低減高性能タイプ Vシリーズ

優れたボイド抑制効果
The excellent reduced void

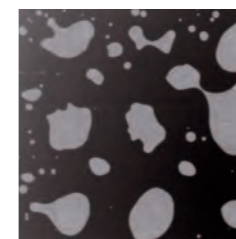
PF305-V302HO



ボイド率2%

従来品

Conventional product

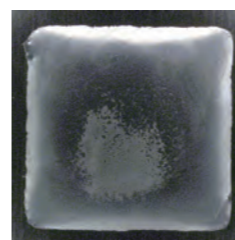


ボイド率25%

- 接合条件 Reflow conditions
- 部品 Parts: 金めっきシリコンチップ
Gold plating silicon chip
 - 試験基板 Test Board: 銅板 Copper plate
 - 大気リフロー Air reflow
 - 予備加熱 Preheating: 150~190°C 90sec
 - ピーク温度 Peak temperature: 240°C

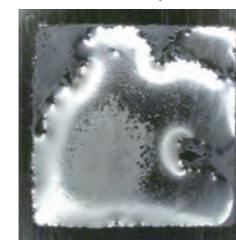
ニッケルへの濡れ性を向上
The excellent wettability to nickel

PF305-V302HO



従来品

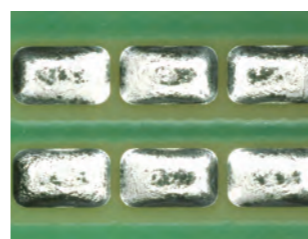
Conventional product



- 接合条件 Reflow conditions
- 試験基板 Test board: ニッケルめっき黄銅板
Nickel plating brass plate
 - 窒素リフロー Nitrogen reflow
 - 酸素濃度 O₂ level: 1000ppm
 - 予備加熱 Preheating: 150~190°C 90sec
 - ピーク温度 Peak temperature: 240°C

優れた洗浄性
The excellent cleaning performance

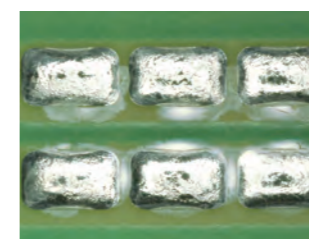
PF305-V302HO



洗浄性良好
Good Cleaning

従来品

Conventional product

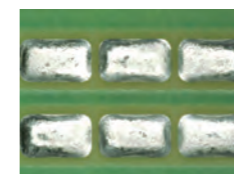


フラックス残渣あり
No Good

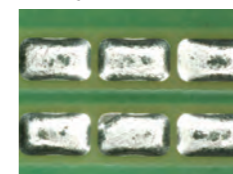
- 接合条件 Reflow conditions
- 予備加熱 Preheating: 150°C 60sec
 - ピーク温度 Peak temperature: 260°C 30sec
 - 洗浄条件 Cleaning conditions
 - アルコール系洗浄液 Alcohols solvent
 - 60°C180sec攪拌 Stirring

各種洗浄液で良好な洗浄性
The excellent cleaning performance by various solvent cleaner

アルコール系
Alcohols solvent



グリコール系
Glycols solvent



炭化水素系
Hydrocarbons solvent

